­Pressemitteilung

Veröffentlichung vom Januar 2024, Wireless

Wireless Design-In   
Drahtlos-Konnektivität, Applikationsprozessor und Sicherheits-Engine in einem SoC integriert  
 **Der Value Added Distributor und Lösungsanbieter HY-LINE Technology GmbH erweitert sein Wireless-Portfolio um die SoCs SiWx917 und SiWx915. Die neuen SoCs sind Matter Ready und ermöglichen IoT-Geräten die drahtlose Konnektivität über Wi-Fi 6 und Bluetooth LE 5.4.**

Zu den Zielanwendungen der SoCs SiWx917 und SiWx915 gehören Smart Homes, Consumer Health, Wearables, Asset Tracking, Medizintechnik, Industrie, Handel, Smart Buildings und Cities.   
Beide SoCs eignen sich für die Integration in netzbetriebene, energieeffiziente IoT-Geräte und unterstützen zum Beispiel das zukunftsweisende Matter over Wi-Fi mit Bluetooth LE Commissioning. Liegt der Designfokus auf IoT-Geräten mit sehr niedrigem Stromverbrauch und ständiger Cloud-Konnektivität, ist der SiWx917 SoC optimal.  
Verschiedene integrierte Subsysteme wie Mikrocontroller (MCU) für Applikationsaufgaben, CPU für Wireless-Tasks und Funktionsblöcke für Sicherheit und Peripherie, verleihen den SoCs eine hohe Leistungsfähigkeit bei geringem Platzbedarf. Das Wireless-Subsystem besteht aus einem Multi-Thread-Prozessor (ThreadArch®) mit bis zu 160 MHz, digitaler Basisband-Signalverarbeitung, analogem Front-End, 2,4-GHz-HF-Transceiver und integriertem Leistungsverstärker.  
Das Anwendungssubsystem besteht aus einem ARM® Cortex®-M4F mit bis zu 180 MHz, eingebettetem SRAM, FLASH und einer für PSA-L2 entwickelten erweiterten Sicherheits-Engine. Der ARM® Cortex®-M4F ist für die Steuerung der integrierten Peripherie und die Verarbeitung anwendungsbezogener Daten zuständig, während der ThreadArch® die Wireless- und Netzwerk-Stacks in unabhängigen Threads ausführt und so eine leistungsfähige, vollständig integrierte Lösung für eine Vielzahl von eingebetteten drahtlosen IoT-Anwendungen bietet. Zusätzlich verfügt der SiWx917 SoC über einen zuschaltbaren AI/ML-Beschleuniger und ein optimiertes Power-Management-Subsystem.  
Der SiWx917 SoC ist in einem 7 x 7 mm QFN-Gehäuse und der SiWx915 SoC in einem 6 x 6 mm QFN-Gehäuse erhältlich.  
HY-LINE bietet umfassende Unterstützung bei der Integration der SoCs in IoT-Geräte, wie zum Beispiel technische Beratung, Unterstützung bei der Auswahl des geeigneten SoCs und Hilfe bei der Integration in die Gesamtlösung. Für die Anwendungsentwicklung mit den SoCs steht beispielsweise die Software-Entwicklungsumgebung Simplicity Studio zur Verfügung.

**Mehr erfahren**SoCs von SILICON LABS -> **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

((Shortcut Link bitte liefern))

**Pressebild**



**A10792-01\_SILICON\_LABS.jpg**

Bildunterschrift:

Mit den SoCs SiWx917 und SiWx915 wird die drahtlose Konnektivität von IoT-Geräten über Wi-Fi 6 und Bluetooth LE 5.4 ermöglicht

--------------------------------------------------------------------------------------

**SEO**

Wireless Design-In, SoCs, Wi-Fi 6, Bluetooth LE 5.4, IoT-Anwendungen, Matter Ready, Matter over Wi-Fi mit Bluetooth LE Commissioning, Drahtlos-Konnektivität, Applikationsprozessor, CPU für Wireless-Tasks, Sicherheits-Engine, Mikrocontroller (MCU) für Applikationsaufgaben, Energy-Management-Funktion, SoCs für Smart Homes, Consumer Health, Wireless Konnektivität für Wearables, Asset Tracking, Medizintechnik, Industrie, Handel, Smart Buildings, Smart Cities, SoC mit Sicherheits- und Peripherie-Subsystem

--------------------------------------------------------------------------------------

HY-LINE Technology GmbH

Inselkammerstr. 10

82008 Unterhaching

E-Mail: sales@hy-line.de

Tel.: +49 89 614 503 10